

## **PUBLIKATIONEN VON PROF. DR. PETER KERSTEN**

*Stand: 10/2015*

- P. Kersten, H. Reichl, "Integration of Thin Film Polyimide with PCB Technology", Circuit World, Vol. 19, No. 4, 16 - 17 (1993).
- P. Kersten, W. Budweiser, H. Reichl, "Dünnschichttechnik auf Leiterplattenlamina-ten", productronic, 10/93, 80 - 82 (1993).
- P. Kersten, V. Glaw, H. Reichl, "Excimer Laser Structuring of Epoxy Resin Layers for MCM-L Applications", Circuit World, Vol. 20, No. 1, 20 - 22 (1993).
- P. Kersten, "Feinstleitertechnik auf Leiterplatten", Workshop Entwurf und Technologien von Multi-Chip-Modulen, Technische Universität Berlin (1993).
- P. Kersten, V. Glaw, H. Reichl, "Excimerlaser - Bearbeitung von Epoxidharz-schichten für MCM-L Anwendungen", productronic, 1/2 94, 40 (1994).
- P. Kersten, G.K.H. Schammler, H. Reichl, "An Additive Approach to Multichip Modules Using Electroless Metallization Processes", The International Journal of Microcircuits & Electronic Packaging, Vol. 17, No.1, 73 - 79 (1994).
- P. Kersten, "Entwurf von Multichip Modulen" und "Verdrahtungssysteme auf der Basis von Leiterplattenlaminaten", eingeladener Vortrag bei der Hewlett-Packard GmbH, Böblingen (1994).
- P. Kersten, "Entwicklung eines Dünnschichtverdrahtungssystems auf der Basis von Leiterplattenlaminaten", Dissertation TU-Berlin, Shaker Verlag, Aachen (1995).
- P. Kersten, S. Bouwstra and J.W. Petersen, "Photolithography on 3D surfaces using electrodeposited photoresists", Sensors and Actuators A 51, 51 - 54 (1995).
- C. Christensen, P. Kersten, S. Henke and S. Bouwstra, "Wafer Through-Hole Interconnections with High Vertical Wiring Densities", IEEE CPMT A, Vol. 19, No. 4, 516 - 522 (1996).
- P. Kersten, "High density substrates for FC and BGA mounting", conference on printed circuit board technology organized by the Fraunhofer-Institute IZM Berlin and the German chapter of IEEE-CPMT, Berlin, January 27-29 (1997).
- P. Kersten, "Warum sind Sacklöcher wichtig ? Erfahrungsbericht über 5 Milliarden gebohrte und galvanisierte Sacklöcher", productronic September 97 (1997).

## **PUBLIKATIONEN VON PROF. DR. PETER KERSTEN**

*Stand: 10/2015*

- P. Kersten, "Why are blind vias important - Report on the experience gained with over 5 billion drilled and plated vias", Printed Circuit Europe, 21-24, No. 4 July-August (1997).
- P. Kersten, "Substratbumping für die Flip-Chip Bestückung", F&M Zeitschrift für Elektronik, Optik und Mikrosystemtechnik, März 98 (1998).
- P. Kersten, "Substrate bumping for Flip Chip assembly", Printed Circuit Europe, No. 8 March-April (1998).
- P. Kersten, "Hochdichte Leiterplatten und die Möglichkeiten für den Schaltungsentwickler", F&M Zeitschrift für Elektronik, Optik und Mikrosystemtechnik, November/98 (1998).
- S. Albrecht, P. Kersten, "Plugging: Ein Schlüsselprozess in der Micro Via Technologie", productronic (1999)
- S. Albrecht, P. Kersten, "Benefits of Hole Plugging for Micro Via Printed Circuit Boards", CircuitTree, September (1999)
- P. Kersten, "Mikrovia Leiterplatten für höchste Verdrahtungsdichten", OTTI Technik Kolleg, Erstes Fachforum Mechatronik am 25. und 26. Oktober (2000).
- P. Kersten, "Mikrovia Leiterplatten für höchste Verdrahtungsdichten", Internationaler Fachkongress Leiterplatten für die UMTS- und HDI/SBU Technologie am 07. und 08. Dezember (2000).
- P. Kersten, "Hochdichte Elektronik, blei- und halogenfrei gefertigt: Anforderungen und Konsequenzen", Vortrag auf dem Rehm Kundenforum am 22. Mai (2001), Zeitschrift Produktion von Leiterplatten und Systemen (PLUS) 08/2001, Eugen G. Leuze Verlag KG (2001).
- Peter Kersten und Wolfgang Schruttker, "Kleberlose Heatsink Verbunde, alternative Schaltungsträger in Leistungsbaugruppen", Elektronik Praxis, Leistungselektronik und Stromversorgung 05/2005 (März 2005).
- Peter Kersten and Juergen Krome, "On road testing of an electric vehicle under different driving conditions", Hybrid and Electric Vehicles, 9th Symposium, February 14th and 15th, Braunschweig (2012).

## **PUBLIKATIONEN VON PROF. DR. PETER KERSTEN**

*Stand: 10/2015*

- Peter Kersten, "Anwendungsorientierte Lehre und Forschung: Methoden und Beispiele an der Hochschule Hamm-Lippstadt", Chinesisch-Deutsches Forum für Internationale Ausbildung (CDIA), Chongqing (2013).
- Peter Kersten und Birka von Schmidt, "Elektromobilität: Vom Technology Push zum Market Pull durch Vernetzung urbaner Lebensbereiche", 9. Symposium für Vorausschau und Technologieplanung, 5. und 6. Dezember 2013, Berlin (2013).
- Andrea Lemke, Peter Kersten und Thomas Ahrens, "Optimierung des Fertigungsprozesses Schablonendruck mit Hilfe der Design-of-Experiment-Methode", Zeitschrift Produktion von Leiterplatten und Systemen (PLUS) 09/2015, Eugen G. Leuze Verlag KG (2015).